日韓経済協力の新地平
～ 経済安全保障と産業共創の現実解 ～

阪南大学 千島智伸

1. 序論：経済安全保障の時代と日韓の再定義

2025 年、日韓は国交正常化から 60 周年を迎える。この節目の年、世界経済は米中対立の長期化、ロシア・ウクライナ戦争の継続、中東情勢の不安定化など、複合的な地政学リスクに直面している。こうしたグローバルイシュー多層化の中で、経済安全保障（Economic Security）は純粋な産業政策を超え、国家戦略そのものの中核へと進化した。とりわけ、技術覇権と供給網（グローバル・サプライチェーン）をめぐる再編が進むなかで、日韓両国の戦略的経済連携は、東アジアの安定と国際競争力維持にとって不可欠な柱となっている。

米国トランプ政権再登場によって、関税政策は同盟国に波及する形で分断され、主要各国は「自国中心の供給網再設計」に取り組んでいる。（OECD, Global Value Chains under Geopolitical Pressure, 2024）、とりわけ半導体・2 次電池・量子通信といった基幹テクノロジー分野を軸に「経済ブロック化」が加速している[1]（Brookings Institution, The Geoeconomics of Supply Chain Fragmentation, 2023）。

こうした中で、日韓はそれぞれが有する産業的特性を活かしながら相互補完的な役割を担い、米国との協調を基盤にしつつも、独自の協調軸を築くことが求められる。その際、政府・産業・学術が連携し、グローバル・サプライチェーン再構築や AI 半導体技術などを議論する継続的な「対話の場」を制度的に確立することが、未来志向の経済安全保障を実現する第一歩といえる。

2. 安保と経済協力の交差点 ― 半導体産業の戦略的連携 ―

現在、経済安全保障の中心に位置するのが半導体産業である。半導体は軍事・宇宙・AI・通信など、あらゆる先端産業の基盤であり、その供給が途絶すれば国家経済の持続性すら危うくなるとしても過言ではない。とりわけ、生成 AI や自動運転、量子通信などの新領域では、高性能チップが国家競争力の源泉であり、半導体技術の確保は技術主権そのものの問題となっている。

日本では、2022 年 8 月に政府の政策支援と民間企業の出資を融合させた体制で設立された Rapidus 株式会社（英文名：Rapidus Corporation） が、2nm 世代の先端ロジック半導体について 2027 年頃からの量産開始を目指している。超高度なデジタル社会の形成に AI が活用され始め、その進化は継続して期待されており、Rapidus の運営は官民協調型プロジェクトとして国家の競争力強化を志向した戦略の柱に位置づけられている。

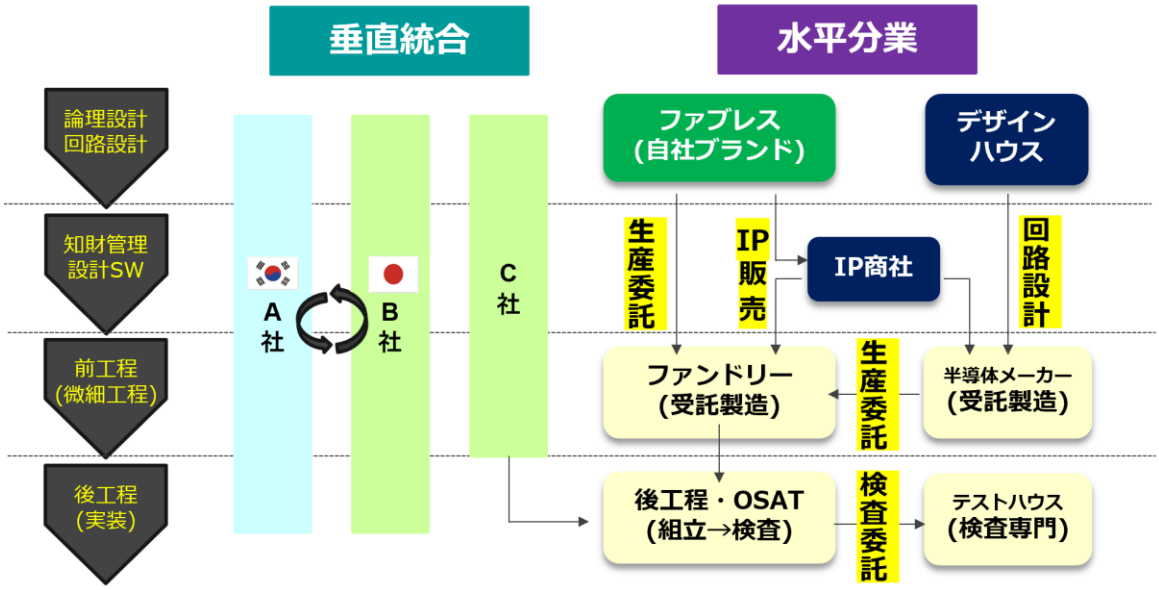
---

[1] https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2023/09/2_Baldwin-et-al_unembargoed.pdf

一方、韓国はサムスン電子と SK ハイニクスを中心に、DRAM・NAND などのメモリ半導体で世界シェアの過半を占め、AI 半導体や先端パッケージング技術の分野でも持続的成長を遂げている。こうした「日本＝上流工程」「韓国＝下流工程」という構造的分業の再構築は、過去の経済協力の歴史からみると容易ではない。1980～1990 年代、日韓両国は部材・製造装置・最終製品の連携を模索したが、知的財産権の扱いや技術移転への不信感などから、日本側に積極的な技術共有姿勢が欠けていたと指摘されている（経産省産業政策史編纂研究会，2018）。このため、日韓間の産業連携は政治・安全保障の緊張に左右されやすく、サプライチェーン上でも「並行的競争関係」に留まってきた経緯がある。

しかし、現在の地政学的状況下では、この二国間の補完構造を戦略的に変化する必要がある。日本の強みは、上流工程における素材（シリコンウエハー、フォトレジスト）、製造装置（露光・エッチング・CMP など）、計測・検査分野での高精度技術にあり、韓国は下流工程の量産、実装（パッケージング、テスト）、および AI チップ開発・国際展開において優位性を持つ。両国の産業優位性を統合する形、すなわち、垂直連携的に結合できれば、日韓がアジア圏における半導体バリューチェーンのハブとなる可能性が見えてくるのではなかろうか。

図 1：半導体サプライチェーンにおける工程表記



また、この取り組みを単なる企業連携にとどめず、両国の研究機関や大学の参画を制度として組み込む方法を提議したい。たとえば、日本の産業技術総合研究所（AIST）や理化学研究所、韓国の韓国科学技術院(KAIST)[2]・電子通信研究院(ETRI)などが共同研究プロジェクトを形

[2] Korea Advanced Institute of Science and Technology, 基礎や先端科学を研究する最難関大学

成し、次世代半導体材料[3]・量子デバイス・AI アーキテクチャ分野で人材交流を進めることは、信頼醸成と技術基盤強化の両面で効果的といえよう。

このような学術・産業一体型の共創モデルは、過去の対立的な分業構造を超え、「知識の共用を通じた安全保障」という新しい日韓協力の枠組みを提示するものである。かつて両国関係を制約してきた「技術の囲い込み」や「知識の非対称性」といった壁を乗り越え、研究段階から成果応用までの知識循環型エコシステムを形成することこそが、持続可能な信頼構築の第一歩となる。特に、半導体・AI・量子通信といった分野では、1 社や 1 国のみでは解決できない課題が増大しており、異なる技術領域を結びつける研究プラットフォームの整備が不可欠である。日韓がそれぞれの技術蓄積・制度設計・教育資源を開放し、大学・研究機関・企業・自治体が相互参画する「マルチステークホルダー型の知識安全保障」は、単なる経済協力の枠を超え、社会的インフラとしての協力モデルへと進化しうるのではないか。この枠組みをインドや東南アジア諸国（ASEAN）に拡張すれば「アジア知識ネットワーク（Asian Knowledge Network）」の形成も見えてくる。すなわち、日韓協力は二国間関係の再構築に留まらず、アジア地域の安定・成長・技術自立に寄与する国際公共財としての意味を持つのである。

3. 米国通商政策と「フレンドショアリング」構造の中での日韓

米国の経済安全保障政策は、従来の「デカップリング（中国との分離）」の枠組みから、「デリスキング（リスクの低減）」という軸へと表現を変えつつある。しかし、実質的には、距離を置く戦略を超えた、同盟国との供給網再編を促進する「フレンドショアリング（友好国偏重型生産移転）」戦略への移行と見るべきではないだろうか。サプライチェーンの分離・分断は、部材・素材の調達停止、原材料コストの上昇、消費者が手にする商品価格の上昇などの副作用が大きいため、現実的にはリスクを伴うからである。こうした中で、日本と韓国はそれぞれ異なる立場で米国経済圏に組み込まれてきたのである。 日本はこれまでに、サプライチェーン多元化を目的に、ベトナム・マレーシア・インドネシア・タイなど東南アジア諸国への製造投資を拡大している。具体的には、SONY がベトナムやタイでイメージセンサーや電子部品の生産体制を強化し、Panasonic はマレーシア・ベトナムを中心に新しい蓄電システム製造やアプライアンス（生活家電）事業を展開している。また、ルネサスエレクトロニクスもマレーシア・クランタン州における半導体後工程の拡張投資を進めており、ASEAN 全体を視野に入れた「分散型生産ネットワーク」の構築は進行中で、いまや「アジア・シリコンバレー」となったマレーシア・ペナン、「東洋のデトロイト」と呼ばれるタイと、地域間連携の効果を想定したサプライチェーンが前提となっている。

---

[3] シリコンを超える性能を持つ新素材を使った半導体のこと

韓国は「米国現地化をベースとする」サプライチェーン強化に取り組み、サムスン電子はテキサス州オースティン、および、テイラーにおいて先端ロジック半導体工場の建設を進め、SK ハイニクスもニューメキシコ州でメモリ製造拠点を拡張している。これにより、米国内での安定供給体制と政治的信頼の強化を図っている。 しかし、これら日韓の動きにはいくつかの課題とリスクが存在する。まず、日本企業による東南アジア展開では、拠点インフラの整備が遅れ、電力供給の不安定さや熟練人材の不足、税制優遇の不確実性といった構造的リスクが依然として存在する。また、サプライチェーン分散は地政学リスクの軽減には寄与するものの、拠点の過度な分散化は逆にグローバル管理コストや物流負担の増大を招く懸念がある。 韓国企業の「米国現地化」も順調ではない。米国の CHIPS 法[4]に基づく補助金支給条件の厳格化や、技術移転義務・データ開示要件に対する懸念、さらには労働コストの上昇や現地調達率規制などが、長期的な採算課題といえる。加えて、さきごろ、米ジョージア州にある韓国・現代自動車の系列工場で、米移民当局の強制捜査によって韓国人労働者 300 人以上が拘束された事件が起きている。サムスン電子や SK ハイニクスの米国内投資判断スピードを鈍化させているとすれば、こうした事象と無関係とはいえないだろう。サプライチェーンは自社から見えない・コントロールできない部分があまりに多く、可視化できていない部分がある事自体がリスクやコストとなる。代替生産のオーダーを付与し、輸送の代替ルートを提供するなどサプライチェーンの可視化を実務的に行う方法に加え、国家間での大局的・戦略的な枠組みを両極として保有しておくことが日韓フレンドショアリングの意味である。したがって、日韓両国が「フレンドショアリング」構造の中で実効的な補完関係効果を得るために、現地投資の政治・制度的リスクを共有・可視化し、両国間で投資保護協定や供給網共通基準を整備する考えに至るのである。

4. 経済協力の新段階：制度・資金・人材の三位一体連携

今後、日韓経済協力を持続的に深化させるには、制度・資金・人材の三位一体連携が挙げられる。経済安全保障の時代において、両国の協力は単発的な事業提携ではなく、制度的裏付けと人的循環を伴う持続的なエコシステム形成へと転換する必要性が外せないからである。

まず、制度面では輸出管理・知財保護・投資審査制度の整合化が対象となる。安全保障貿易管理（CISTEC や韓国戦略物資管理院など）間の定期協議は形式的な制度から実利ベースを目指すことで、政治リスクによる時間停滞や両国間の調整コストは抑制しやすくなるであろう。

資金面では、2023 年に日本経済団体連合会が「日韓未来パートナーシップ基金」の創設と、

[4] Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act (米国内半導体産業の振興を目的とした法律)

翌 2024 年には人材交流を促進するための規模拡大を発表しているが、こうした「日韓経済安全保障ファンド要素」を持つ資金の現実的な使用・活用が挙げられる。官民ファンドによる研究支援やスタートアップ投資は、共同研究のリスク分散と成果の共有を実現するうえで有効な枠組みである。しかし同時に、研究・技術開発の初期段階において先行している側にとっては、技術的優位を保持するインセンティブが働くため、成果を積極的に共有しづらいという心理的・戦略的障壁が存在する。この「非対称なモチベーション構造」を放置すれば、共同研究の名の下に一方が情報を提供し、他方が受益するという構図になりかねず信頼関係の持続を妨げる要因となる。

したがって、日韓経済安全保障ファンドを効果的に運用するためには、資金拠出だけでなく、成果共有とリターン配分を制度的に設計する仕組みが必要である。たとえば、研究段階ごとに成果指標（KPI）を設定し、一定の成果到達ごとに次フェーズの支援額を段階的に拡充する「ステージ型支援モデル」や、知的財産の利用権を共同保有ではなく“期間限定・用途限定ライセンス制”とするなど、インセンティブを調整する枠組みが考えられる。

人材面では、両国の大学・研究機関・企業は、トライラテラル（日米韓）人材交流プログラムを作り、次世代半導体・AI・量子通信などの分野で高度人材の育成方法を早急に議論することが望ましい。特に、経済安全保障の時代においては、研修や留学の枠を超えた「労働市場の流動化を前提とした人材循環」が必要で、そのための制度的枠組みの整備が重要と指摘できる。

5. 結語：経済安全保障から共創経済へ

これからの経済安全保障を基盤とした日韓連携とは、「協力と競争の調和」を実現するための実践的モデルである。Rapidus、SONY、サムスン電子、SK ハイニクスといった企業の連携は、国際政治環境の不確実性に対し柔軟に対応し、アジア全体の安定的成長を支える仕組みを軽視すべきではない。

2025 年という節目の年、日韓両国が「競争」から「共創」へと歩を進めることは、単なる過去の克服ではなく、未来の設計そのものである。技術・制度・安全保障を横断する共創の枠組みこそ、これからのアジアが世界に示すべき新しい経済モデルであり、対立や差異を超えて築かれる協働のプロセス、すなわち、技術・制度・安全保障を横断する共創の枠組みは両国にとって新しい経済モデルを世界に示す機会になるのではないだろうか。こうした協力関係は、「一過性の政策連携」ではなく、中長期的な共創経済（Co-Creative Economy）の形成に向けた出発点になることをあらためて指摘したい。

以　上